

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-026

## 锦州神工半导体股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2026年5月29日
  - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2026年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2026年5月29日 14:00分
- 召开地点:公司会议室(辽宁省锦州市太和区中信路46号甲)
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年5月29日
- 至2026年5月29日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 不涉及
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开符合特定对象发行 A 股融资方案的议案	√
2	关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股融资方案的议案	√
2.01	发行对象和发行范围	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行价格和认购方式	√
2.04	发行数量与定价原则	√
2.05	增加条款	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行募集资金用途	√
2.08	本次特定对象发行募集资金未分配利润安排	√
2.09	上海浦东	√
2.10	本次特定对象发行股票涉及锁定期	√
3	关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股融资授权的议案	√
4	关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股融资发行方案论证分析报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股融资募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司本次募集资金使用授权的专项报告的议案	√
7	关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股融资摊薄即期回报及填补措施和本次募集资金用途的议案	√
8	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案	√
9	关于公司本次募集资金使用授权科技研发创新专项报告的议案	√
10	关于公司本次特定对象发行 A 股融资募集资金专项存储账户的议案	√
11	关于授权公司董事会薪酬委员会及董事会授权人士全权办理本次特定对象发行 A 股融资相关事宜的议案	√

1. 说明有关议案已被披露的时间及披露媒体
- 本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,相关公告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2026年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载会议资料。
2. 特别决议议案:1-11
3. 对中小投资者单独计票的议案:1-11
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

- 三、股东大会选举事项
- (一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的公司交易系统)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作办法是登录网络投票平台网站说明。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (三) 持有多个表决权账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东大会所持有全部普通股和相同品种优先股的总和相同。

- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一票意见的表决书。
- 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种投票的第一次投票结果为准。

- (四) 股东大会所有议案均表决完毕才可提交。
- 四、会议出席对象
- (一) 股东大会登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股份代码	简称	股权登记日
A股	688233	神工股份	2026/05/22

- (二) 公司董事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员
- 五、会议登记方法
- (一) 登记手续

1. 自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证件和证券账户卡或有效权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效权证明原件和身份证复印件、授权委托书(格式见附件1)和委托人身份证复印件办理登记手续。
2. 企业股东法定代表人/执行事务合伙人代表亲自出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效权证明原件办理登记;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效权证明原件办理登记手续。
3. 异地股东可以通过传真方式登记,但须经传真以抵达公司时间为准,在来自或传真上须写清楚股东姓名、股东账号、联系地址、邮编、联系电话,并附上述 1、2 款所列的证明材料复印件,请传真注明“股东大会”字样,会议期间如需携带证件,公司不接受电话方式办理登记手续。

- (二) 登记时间:2026年5月28日上午8:30至12:00分,下午13:00分至17:00分。
- (三) 登记地点:公司证券办公室。

- 六、其他事项
- (一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;
- (二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理登记;
- (三) 会议联系方式

1. 联系地址:辽宁省锦州市太和区中信路46号甲
2. 联系电话:0416-7119899
- 特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会  
2026年5月14日

附件 1:授权委托书

锦州神工半导体股份有限公司:  
委托托 先生(女士)代表本人(或人)出席 2026年5月29日的贵公司 2026年第二次临时股东大会,并代

行为授权事项:

委托托 持普通股票;

委托托 持优先股;

委托托 人股东账户号:

序号	重要事项议案名称	投票	复权
1	关于召开符合特定对象发行 A 股融资方案的议案		
2.01	关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股融资方案的议案		
2.02	发行对象和发行范围		
2.03	发行方式和发行时间		
2.04	发行价格和认购方式		
2.05	发行数量与定价原则		
2.06	增加条款		
2.07	本次发行的募集资金用途		
2.08	本次特定对象发行募集资金未分配利润安排		
2.09	上海浦东		
2.10	本次特定对象发行股票涉及锁定期		
3	关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股融资授权的议案		
4	关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股融资发行方案论证分析报告的议案		
5	关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股融资募集资金使用可行性分析报告的议案		
6	关于公司本次募集资金使用授权的专项报告的议案		
7	关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股融资摊薄即期回报及填补措施和本次募集资金用途的议案		
8	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案		
9	关于公司本次募集资金使用授权科技研发创新专项报告的议案		
10	关于公司本次特定对象发行 A 股融资募集资金专项存储账户的议案		
11	关于授权公司董事会薪酬委员会及董事会授权人士全权办理本次特定对象发行 A 股融资相关事宜的议案		

委托托(签名): 委托托(签名):  
委托托(身份证): 委托托(身份证):  
委托托(日期): 年 月 日  
备注:

委托托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 锦州神工半导体股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股 股票预案披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件,敬请广大投资者注意查阅。

本次发行预案及相关信息披露事项不代表构成,注册部门对于本次发行相关事项的真实性判断,批准或注册,预审承诺不构成对本次发行相关事项的实质性判断,不构成上海证券交易委员会注册并经过中国证监会同意注册后方可实施,公司将根据本次发行的进展情况,按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

锦州神工半导体股份有限公司董事会  
2026年5月14日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-026

## 锦州神工半导体股份有限公司关于 向特定对象发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开的第三届董事会第十四次会议,审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国办发〔2004〕17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等文件的有关规定,公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

- 一、本次特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
- 本次特定对象发行募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),本次发行完成后,公司的总股本和净资产将有一定幅度的增加,由于募集资金投资项目产生效益需要一定的时间和过程,短期内公司存在每股收益摊薄和净资产收益率下降的风险,具体情况如下:
- (一) 财务指标计算的主要假设和前提
- 公司基于以下假设条件对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析:
1. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境及产品市场情况等方面没有发生重大变化;
  2. 假设本次发行方案于2026年11月末实施完毕,被稀释期间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不构成对本次发行实际完成时间的判断,最终以中国证监会备案无异议后实际发行完成时间为准;
  3. 假设发行数量为17,000,000股(以截至项目启动前股本170,306,736股的10%计算),募集资金总额为100,000.00万元,不考虑相关发行费用;本次特定对象发行股票数量及募集资金规模将根据监管部门审核,发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;
  4. 在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响;
  5. 公司2026年度归属于上市公司股东的净利润为10,383.71万元,其他数据按照按照归属于上市公司股东的净利润10,022.24万元;
  6. 假设公司2026年归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较以下三种假设情况进行:1)较2025年减少10%;2)与2025年持平;3)较2025年增加10%。该假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;
  7. 假设2026年除本次发行外,不存在其他导致公司总股本变化的因素;
  8. 不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2026年盈利情况的承诺,也不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二) 对本次主要财务指标的影响

基于上述假设前提,本次发行对公司主要财务指标的影响测算对比如下:

项目	2026年度(2026.12.31)	2025年度(2025.12.31)	本次发行后
原总股本(万股)	17,030.07	17,030.07	18,730.07
本次发行募集资金总额(万元)			1,700.00
假设发行—2026年归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年减少10%	10,383.71	9,384.34	9,384.34
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,383.71	9,384.34	9,384.34
归属于上市公司股东的每股净利润(元/股)	0.609	0.551	0.501
归属于上市公司股东的净资产(万元)	10,022.24	9,024.02	9,024.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.60	0.54	0.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.59	0.53	0.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.59	0.53	0.53
假设发行—2026年归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年持平	10,383.71	10,383.71	10,383.71
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,383.71	10,383.71	10,383.71
归属于上市公司股东的每股净利润(元/股)	0.609	0.609	0.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.60	0.54	0.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.59	0.53	0.53
假设发行—2026年归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年增加10%	11,422.08	11,422.08	11,422.08
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,422.08	11,422.08	11,422.08
归属于上市公司股东的每股净利润(元/股)	0.671	0.671	0.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.60	0.54	0.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.59	0.53	0.53

注:每股收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

二、关于本次特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次募集资金投资项目后,公司的总股本和净资产均有一定幅度的增加,由于募集资金投资项目存在一定的实施周期,可能在短期内难以实现预期效益,从而存在本次发行完成后每股收益被摊薄的风险。此外,一旦部分现有资产或公司经营状况发生重大变化,不能排除本次发行导致短期内被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次发行可能对摊薄即期回报的影响。

三、本次特定对象发行股票的必要性和合理性

本次募集资金投资项目符合了“双碳”目标,项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力和风险防范能力,具有充分的必要性和可行性。

关于本次特定对象发行募集资金投资项目的必要性和合理性具体分析,详见《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》之“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

(一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次向特定对象发行募集资金在扣除发行费用后将用于主营业务相关项目建设,募集资金投资项目属于围绕现有业务的研发及产品研究,技术升级与产业升级,有望进一步丰富公司产品矩阵,提高公司核心竞争力,增强可持续发展能力,促进公司高质量发展转型。

公司为国内领先的半导体材料、半导体器件生产企业,本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司未来整体战略发展方向,有利于提升公司的综合实力,对公司的长期发展具有积极意义。

(二) 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

公司“科技创新、技术驱动”为理念,以“专业技术、精准测量、服务客户”为经营理念,致力于成为市场地位高、技术优势和研发实力强、有高性价比产品,有良好品质管理及售后服务的优秀半导体材料和半导体器件供应商。公司将继续深耕于半导体行业,凭借丰富的行业经验,持续提升研发实力,持续吸纳国内有一定基础的中高级技术人员,引进并加强中国本土技术人才梯队,提升公司在人才方面的竞争优势。截至2026年3月末,公司研发人员67人,占员工总数的23.02%,主要研发人员具有丰富的行业工作经验。

技术储备方面,公司拥有“硅基器件精密加工”、“半导体硅在硅基技术”两大核心方向,同步自主研发智能化管控软件,深耕半导体硅基材料及应用产品赛道,研发成果丰硕,专利申请与授权工作稳步推进,进一步夯实了公司“材料+零部件”一体化核心竞争力优势,为业务高质量发展提供有力技术支撑。公司在硅基器件上的技术储备十分丰富,已有20余项核心技术,截至2026年3月31日,公司拥有107项专利,其中19项为发明专利,88项为实用新型专利,公司荣获国家专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业等多项证书,充分证明公司的技术储备及研发实力。

市场储备方面,公司已取得了中国本土半导体器件的领先地位,已进入了中国主流硅基芯片制造商及等高端制造领域的供应链,其高纯度品类为,发挥了独特的国产化优势。公司已拓展了国内领先的半导体供应链中,硅材料直接供货给日本、韩国等地的知名硅器件厂商。后者的产品销往国际知名硅基设备厂商,例如美国泛林集团(Lam Research)和日本东芝电子(Tosky Electron Lamist,TEL),并销售给销售三星和台积电等国际知名集成电路制造商。高端产业链丰富且技术雄厚,同时公司已取得本土硅基器件市场的领先地位,已进入了中国主流硅基芯片制造商及等高端制造领域的供应链,以高纯度品类为,发挥了独特的国产化优势,市场空间潜力大。

五、公司对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为本次发行募集资金投资项目有效使用,有效的即期回报被摊薄的风险,提升公司未来的回报能力,公司拟采取一系列措施以提升公司经营业绩,为股东创造回报,具体如下:

(一) 加强募集资金管理,确保募集资金有效使用

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及用途的监管等方面做出了具体的管理规定。本次募集资金到位后将存放于公司董事会决议开设的专项账户,并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,确保募集资金专款专用,同时,公司将严格遵守相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定,在进行募集资金投资项目时,严格履行资金支出审批手续,明确各控制环节的相关责任,按项目计划申请、审批、使用募集资金,并及时履行相关信息披露义务。

(二) 薪酬, 避免实施股权激励投资项目, 实现项目预期回报

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展,符合国家产业政策、行业发展趋势与公司发展战略,可有效提升公司业务实力、技术水平,从而进一步巩固公司的市场地位,提高公司的盈利能力与综合竞争力。公司已充分做好了募集资金投资项目的前期研究工作,对募集资金投资项目所涉及行业进行了深入的了解和研析,结合行业趋势、市场前景及公司自身等基本情况,最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目的实施,争取早日投产并实现预期效益。

(三) 不断完善公司治理, 进一步提高经营管理能力

公司已建立健全了内部管理体系,能够保证公司各项经营运作得到有效开展,公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、法规、规章及规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,进一步提高经营管理能力,完善决策程序,优化管理流程,强化执行监督,促进公司治理规范,全面提升公司的经营效率和效果,保护公司和投资者的合法权益。

(四) 持续完善内部控制, 加强资金使用管理和内控审核考核

公司将进一步完内部控制, 加强资金管理, 防止资金被挪用用于非经营性活动, 提高资金使用效率, 严格控制费用支出, 加大成本控制力度, 降低运营成本, 提升公司利润率; 加强对管理层的考核, 将管理层薪酬水平与公司经营效益挂钩, 确保管理层的勤勉、尽责, 保障公司持续、稳定、健康发展。

(五) 完善利润分配政策, 优化投资者回报机制

公司制定了详细的利润分配原则、利润分配规划与计划、利润分配形式、利润分配政策的期间、利润分配的条件、利润分配的比例、利润分配的决策程序和机制、分配利润的发放、利润分配政策的信息披露、利润分配政策的调整机制; 在具备现金分红的前提下, 公司应当优先采取现金方式分配股利, 且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配的利润的10%。此外, 公司还制定了《锦州神工半导体股份有限公司未来三年(2026-2028)年股东分红回报规划》, 进一步明确了未来三年(2026-2028)年的利润分配政策, 积极落实对股东的利润分配, 促进投资者持续、稳定、科学的回报, 切实保障投资者的权益。

(六) 其他方式

公司承诺未来将积极和中国证监会、证券交易所等监管机构沟通出具的具体措施及要求, 持续完善填补摊薄即期回报的各项措施。

此外, 公司提示广大投资者, 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

1. 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
2. 对个人的职务消费行为进行约束, 在商务活动过程中本着节约原则行事, 不奢侈、不铺张浪费;
3. 不得用公司资产从事与履行职务无关的投资、消费活动;
4. 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5. 若公司未实施股权激励计划, 股权激励计划的授予条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6. 本承诺出具日后, 如中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定, 且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所等相关规定的, 本人将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺;
7. 若违反上述承诺或不履行上述承诺, 本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施, 同时, 若违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会  
2026年5月14日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-026

## 锦州神工半导体股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和 证券交易所处罚或采取监管措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)始终严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章以及《锦州神工半导体股份有限公司章程》的相关要求, 致力于不断完善公司治理结构, 建立健全内部控制制度, 促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟向特定对象发行人民币普通股(A股)股票, 现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下:

1. 公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
2. 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
3. 公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及处罚的情况
4. 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会  
2026年5月14日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-024

## 锦州神工半导体股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会颁布发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定, 锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“本公”或“公司”)将截至2026年3月31日止的前次募集资金使用情况公告如下:

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准, 公司采用非公开发行股票的方式, 向特定对象发行人民币普通股(A股)股票, 募集资金总额为人民币299,499,974.96元, 扣除发行费用后实际募集资金总额为人民币296,066,578.74元, 上述资金到位情况已经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)普永验字[2023]11020012号《验资报告》验证。

为了规范募集资金的管理和使用, 提高募集资金使用效率, 保护投资者的合法权益, 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”), 对公司募集资金的存放、使用及用途的监管等方面做出了具体的管理规定, 并按管理制度规定存放、使用、管理资金。

2023年9月, 公司、国泰君安证券股份有限公司(曾用名:国泰君安证券股份有限公司)与招商银行股份有限公司(曾用名:招商银行股份有限公司)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 监管协议不存在重大遗漏, 公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

截至2026年3月31日, 公司前次募集资金余额(含银行理财)为0.00元。前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

银行账户	账号	账户类型	期初资金余额(元)	余额(元)
招商银行股份有限公司	41000037710703	活期	210,000,000.00	活期, 零余额
中国工商银行股份有限公司	07000432300690004	定期	86,066,578.74	活期, 零余额
合计			296,066,578.74	

注:1. 期初募集资金与实际募集资金净额差943,396.22元, 系从募集资金专户中用于支付审计验资费、律师费等与发行权益类证券直接相关的外部费用支出。

注:2. 募集资金项目的“补充流动资金”对应募集资金已全部按合同约定投入使用, 为方便银行账户, 公司于2024年12月将募集资金项目投入人民币0.14万元充到公司银行账户, 同时公司将在中国工商银行股份有限公司锦州支行锦州支行开立募集资金专户(账号:07000432300690004)。

注:3. 根据公司于2026年1月28日召开的第三届董事会第十四次会议、2026年2月10日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将公司募投项目“集成电路制造设备用硅材料扩产项目”予以终止, 并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。

注:4. 根据公司于2026年3月13日召开的第三届董事会第十四次会议、2026年2月10日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将公司募投项目“集成电路制造设备用硅材料扩产项目”予以终止, 并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。

注:5. 根据公司于2026年3月13日召开的第三届董事会第十四次会议、2026年2月10日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将公司募投项目“集成电路制造设备用硅材料扩产项目”予以终止, 并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。

注:6. 根据公司于2026年3月13日召开的第三届董事会第十四次会议、2026年2月10日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将公司募投项目“集成电路制造设备用硅材料扩产项目”予以终止, 并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。

注:7. 根据公司于2026年3月13日召开的第三届董事会第十四次会议、2026年2月10日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将公司募投项目“集成电路制造设备用硅材料扩产项目”予以终止, 并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。

注:8. 根据公司于2026年3月13日召开的第三届董事会第十四次会议、2026年2月10日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将公司募投项目“集成电路制造设备用硅材料扩产项目”予以终止, 并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。

注:9. 根据公司于2026年3月13日召开的第三届董事会第十四次会议、2026年2月10日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将公司募投项目“集成电路制造设备用硅材料扩产项目”予以终止, 并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。

注:10. 根据公司于2026年3月13日召开的第三届董事会第十四次会议、2026年2月10日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将公司募投项目“集成电路制造设备用硅材料扩产项目”予以终止, 并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。

注:11. 根据公司于2026年3月13日召开的第三届董事会第十四次会议、2026年2月10日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将公司募投项目“集成电路制造设备用硅材料扩产项目”予以终止, 并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。

注:12. 根据公司于2026年3月13日召开的第三届董事会第十四次会议、2026年2月10日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将公司募投项目“集成电路制造设备用硅材料扩产项目”予以终止, 并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。

注:13. 根据公司于2026年3月13日召开的第三届董事会第十四次会议、2026年2月10日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将公司募投项目“集成电路制造设备用硅材料扩产项目”予以终止, 并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。

注:14. 根据公司于2026年3月13日召开的第三届董事会第十四次会议、2026年2月10日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将公司募投项目“集成电路制造设备用硅材料扩产项目”予以终止, 并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。